

Präzisions-Esd-Sicherer Peek-Wafer-Vakuumsaugstift Für Die Handhabung Von 8-Zoll-Halbleiter- Und Photovoltaiksubstraten

Artikelnummer: PL-CP115



Einführung

Leistungsstarker, ESD-sicherer PEEK-Wafer-Vakuumsaugstift, entwickelt für die präzise Handhabung von 8-Zoll-Wafern in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. Diese anpassbare Lösung bietet überlegende chemische Beständigkeit und mechanische Haltbarkeit für kritische Reinraumumgebungen und empfindliche Substrattransferprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Waferinspektion	Manueller Transfer von 8-Zoll-Siliziumwafern zu und von optischen oder SEM-Inspektionsstationen.	Minimale Kontaktfläche reduziert das Risiko von Oberflächendefekten.
Sortierung von Photovoltaikzellen	Handhabung und Sortierung von hocheffizienten Solarzellen während der Montage- und Testphasen.	Verhindert Mikrorisse und erhält die Zelleneffizienz durch sanften Vakuumgriff.
Nassbank-Prozessierung	Transfer von Substraten zwischen Chemiebädern oder Spülstationen in nasschemischen Umgebungen.	Hervorragende Beständigkeit gegenüber harten Prozesschemikalien und Feuchtigkeit.
Dünnschichtabscheidung	Platzieren und Entfernen von Substraten aus PVD/CVD-Vakuumkammern oder Load-Locks.	Hohe thermische Stabilität ermöglicht die Handhabung nach Hochtemperatur-Abscheidungszyklen.
Reinraum-F&E	Allgemeine Substrathandhabung in Einrichtungen für Forschung und Entwicklung neuer Materialien.	Erfüllt strenge ISO-Reinheitsstandards durch Minimierung der Partikelabgabe.
Vorbereitung Die Bonding	Manuelles Positionieren von Wafern für das Zerteilen oder nachfolgende Die-Bonding-Operationen.	ESD-sichere Eigenschaften verhindern latente Defekte in empfindlichen Mikroschaltkreisen.
LED-Substrathandhabung	Präzisionsmanipulation von Saphir- oder SiC-Substraten während der LED-Chip-Herstellung.	Sicherer Halt auf harten, polierten Oberflächen ohne Verrutschen oder Kratzer.

Spezifikationskategorie	PL-CP115 Spezifikationsdetails
Modellidentifikation	PL-CP115 Serie
Primäres Material	Leistungsstarker ESD-sicherer PEEK
Substratkompatibilität	Vollständig anpassbar (Optimiert für 8-Zoll/200mm Wafer)
Oberflächenwiderstand	Anpassbar an angegebene ESD-sichere Bereiche (z. B. $10^6 - 10^9 \Omega$)
Betriebstemperaturbereich	Angepasst an Prozessanforderungen
Chemische Kompatibilität	Universell (Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Lösungsmitteln)
Vakuumschlusstyp	Maßgeschneiderte Größe zur Anpassung an Vakuumleitungen der Anlage oder tragbare Pumpen
Spitzenkonfiguration	Benutzerdefinierte Formen (flach, gekrümmt, mehrpunktig) auf Anfrage erhältlich
Reinraumklassifizierung	Kompatibel mit ISO-Klasse 3 - 8 (Anwendungsabhängig)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Spezifikationskategorie	PL-CP115 Spezifikationsdetails	
Herstellungsmethode	Präzisions-CNC-gefertigt nach Maßspezifikationen	
Griffabmessungen	Ergonomisch angepasst an Kundenpräferenzen	